编号：HoS20260627-54
版本：A0

产品承认书

客户名称：

产品名称：封体合金电阻

产品规格：HoYLR0805-1/2W-10mR-1%

产品编码：

文件制作：2026-06-27

本公司核准签章			
制作	审核	批准	公司印章
廖振焕	黄永康	冷文义	

客户确认签章			
承认	审核	批准	承认印章

目的

通过本承认书对样品特性和检验标准的描述，更好的与客户沟通，与客户达成一致意见，避免因未充分沟通而引起的产品质量纠纷。

适用范围

本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供的样品，适用于产品的特性及产品的检验标准。

订单关联

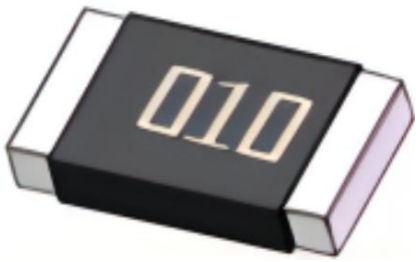
客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规格型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认，本承认书于客户收到日起两周后默认生效。

产品特点

1. 合金芯片
2. 封体工艺
3. 焊接性能良好
4. 高可靠性
5. 过高载能力
6. 产品精度高
7. 使用温度范围较宽无感型设计
8. 符合ROHS要求和无卤要求

产品应用范围

1. 电源模块
2. 工业仪器设备
3. 变频驱动
4. 伺服驱动系统
5. 自动化控制系统



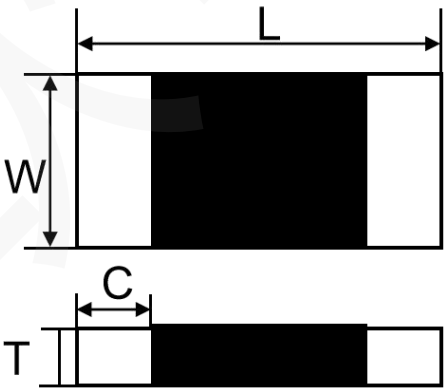
高新技术企业 IATF16949 ISO9001 RoHS REACH

选型示例：HoYLR0805-1/2W-10mR-1%	封体合金电阻

Ho	YLR	0805	1/2W	10mR	1%
↓	↓	↓	↓	↓	↓

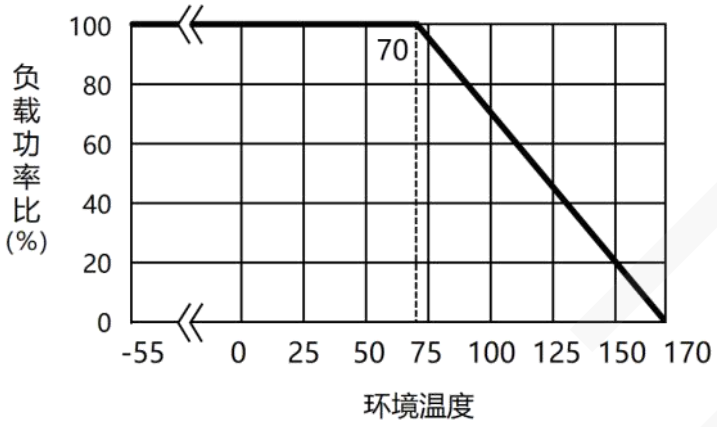
制造商	产品系列	封装	功率	阻值	精度
Ho毫欧电子	YLR	0805	1/2W	10mR	±1%

产品尺寸

项目	参数		
尺寸(mm)	L（2.0±0.1）	W（1.25±0.1）	C（0.4±0.2）
	T（0.6±0.2）		
产品编码：			
额定功率	1/2W		
最大额定电流	7.07A		
温漂	±50ppm/℃		
阻值	10mR		
工作温度范围	-55℃~+170℃		
客户确认	客户签名：		签名时间：
备注			

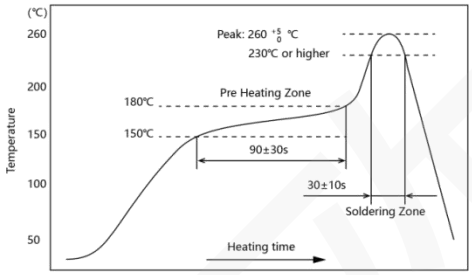
深圳市毫欧电子有限公司
受控文件

功率曲线

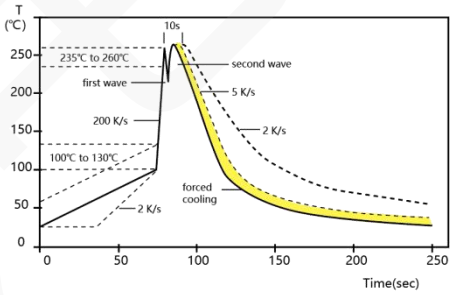


操作温度范围-55~+170℃，电阻温度达到70℃时降功率示意图

建议焊接参数



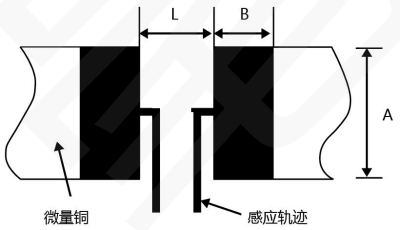
回流焊曲线图



波峰焊曲线图

预热150至180℃，90±30秒，焊接区：230℃或更高，30±10秒，峰值：260±5℃，5秒

建议焊盘尺寸（单位：mm）



阻值	A	L	B
10mR	1.4±0.1	1.2±0.1	1.15±0.1

额定电流计算公式

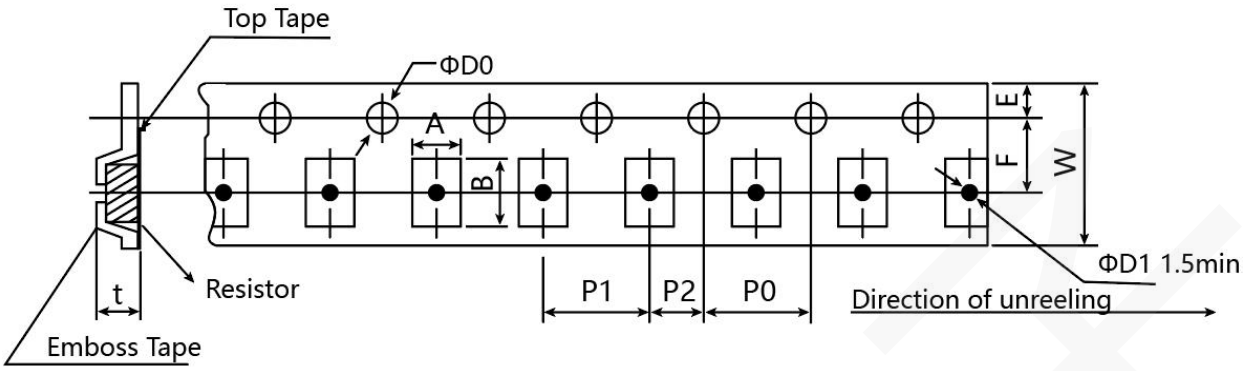
$$I=\sqrt{P/R}$$

I	P	R
额定电流(A)	额定功率(W)	电阻值(Ω)

■ 可靠性测试

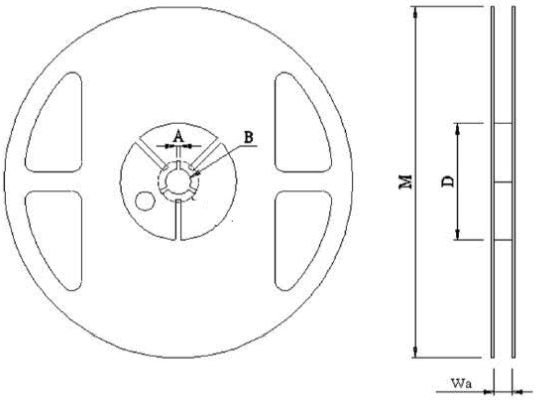
测试项目	标准	测试条件	测试限值
短时间过载	JIS-C 5201	5倍额定功率，5秒	≤±0.5%
温度系数	JIS-C 5201	+25℃~+125℃	参考物理特性TCR规格
高温高湿	MIL-STD-202	85℃，85%相对湿度，1000小时,加载10%额定功率	≤±0.5%
温度循环	JIS-C 5201	-55℃~+125℃循环1000次后取出静置24±4小时	≤±0.5%
耐溶剂	JIS-C 5201	浸于20~25℃异丙醇溶剂60±5秒	≤±0.5%
低温放置	JIS-C 5201	-55±2℃恒温箱中1000小时	≤±0.5%
高温放置	JIS-C 5201	170℃之烤箱中1000小时	≤±1.0%
负荷寿命	JIS-C 5201	额定功率下1000小时，70℃，“开”1.5小时“关”0.5小时	≤±1.0%
抗焊锡热	MIL-STD-202	260±5℃，10±1秒	≤±0.5%
可焊性	J-STD-002	浸于245±5℃之炉中3 ±1秒	电极覆新锡面积需大于95%
绝缘电阻试验	JIS-C 5201	置于治具上，在正负极施加100VDC一分钟	>100MΩ
焊锡粘合强度	JIS-C 5201	焊于弯折性测试板中，置于弯折测试机上，在测试板中央施力下压于负荷下量测阻值变化率	≤±0.5% 外观无损伤

载带尺寸



A	B	W	F	E	P1	P2	P0	D1	T
1.6±0.2	2.4±0.2	8±0.2	3.5±0.05	1.75±0.1	4.0±0.1	2±0.05	4±0.05	Φ1.5+0.1	0.84±0.15

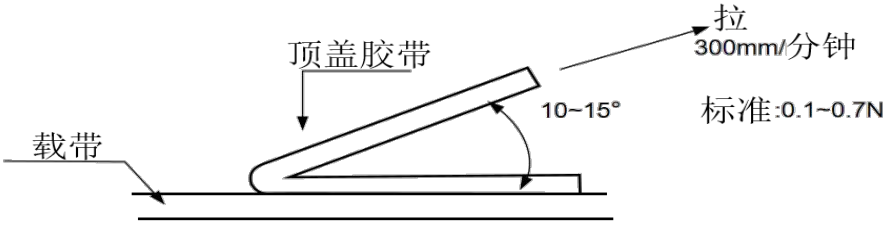
卷轴规格



ϕD	ϕM	ϕB	W	A	编带盘装
60±1	178±2	13.5±1	9±0.5	2±0.5	5000pcs/盘

上带的剥离强度

剥离速度:300毫米/分钟；剥离力在0.1N至0.7N之间



产品包装及使用说明:

1、产品包装

编带盘装：5000PCS/盘；

2、产品使用说明

①产品使用过程中，注意表面防护、防止产品表面出现碰伤、划伤等缺陷。

②产品安装使用时，避免产品受到机械应力的影响。

③ 产品的长期使用功率应小于或者等于额定功率，避免长期使用过载引起的阻值漂移。

④ 当在高温或散热不佳额条件下使用产品时，应参考降功耗曲线进行降额应用。

3、产品存储说明

① 产品储存环境温度为5~35℃，湿度＜65%RH，且湿度应尽量保持在低水平。

② 产品需存放在干净干燥、无有害气体的环境下。

③ 产品未使用前，需避免将产品从包装中取出。

④ 在上述储存条件下，产品可保持1年。

⑤ 1年以上产品，检查表面有无氧化，需进行焊接测试。